

## 教育经历

学位(加注英文)	时间	国家	院校	专业
理学学士/B.S.	1978/02-1982/01	中国	吉林大学	半导体材料
理学硕士/M.Sc.	1982/02-1985/01	中国	吉林大学	物理化学
理学博士/Ph.D.	1986/06-1992/06	美国	加州理工学院	物理化学

## 工作经历

职务	时间	国家	单位
博士后	1992/06-1994/04	美国	加州理工学院
博士后	1994/04-1995/10	美国	洛斯阿拉莫斯美国国家实验室
高级工程师	1995/10-2010/01	美国	英特尔公司
联合创始人	2016/09-今	中国	深圳修远电子科技有限公司
研究教授	2018/11-今	中国	南方科技大学

## 研究简介

量子化学方法和 molecular dynamics 方法研究材料的电、热，和机械性能。

高性能集成电路芯片封装的研发，量产。

打线 (wire bonding)，倒装 (flip chip)，和扇出 (fanout) 等封装工艺和材料方面的研发和量产制造。

## 所获荣誉

得到了十次 Intel 部门最高奖 (Divisional award)

## 代表文章

发表时间	论著 (论文) 名称	发表载体	论著 (论文) 作者
------	------------	------	------------

1988/02	Electronic structure and valence-bond band structure of cuprate superconducting materials.	Science 1988, 239 (4842), 896-899	Y. Guo, J-M. Langlois, and W. A. Goddard III
1989/01	<u>Magnon-Exchange Pairing and Superconductivity</u>	Science 1989, 243 (4890), 547-548	G. Chen, J-M. Langlois, Y. Guo, and W. A. Goddard III
1991/06	Prediction of fullerene packing in C60 and C70 crystals	Nature 1991, 351, 464 - 467.	Y. Guo, N. Karasawa, and W. A. Goddard III
1993/06	Electron-Phonon Interactions and Superconductivity in K3C60	Phys. Rev. B 1993, 48 (18), 13959-13970	G. Chen, Y. Guo, N. Karasawa, and W. A. Goddard III
1995/05	Is carbon nitride harder than diamond? No, but its girth increases when stretched (negative Poisson ratio)	Chemical Physics Letters 1995, 237 (1-32), 72-76.	Y. Guo and W. A. Goddard III
2000/08	Flip-Chip Technology on Organic Pin Grid Array Packages	Intel Technology Journal	Lij, M. Sankman, B., Azimi, H., Yeoh, H. & Guo, Y.

## 联系方式

邮箱：[guoyj@sustc.edu.cn](mailto:guoyj@sustc.edu.cn)

南山智园 B2 栋 19 楼